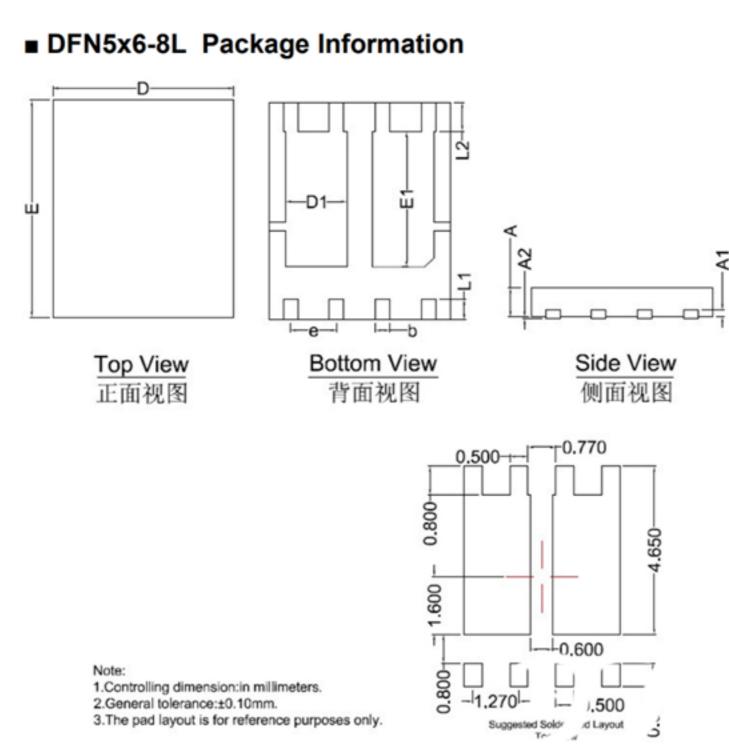


New Product Announcement 新产品发布

应用于散热风扇的NP合封MOSFET

产品介绍 🕥

- 1.产品采用DFN5060-8L N+P 双芯框架合封的产品,相对DFN3333(3.3 X 3.3 mm)同类封装,具有更好的散热能力,输出功率和电流更强,更适用于对于功率有更高要求的风扇;
- 2.产品具有过流能力强,热阻低,更宽范围的SOA的特点;
- 3.N MOS与P MOS 合封,简化电路桥接结构的同时保留工程师应用的灵活性;
- 4. Vds耐压分别为30V / 60V / 100V 针对12V / 24V / 48V 风扇系统应用。



SYMBOL	MILLIMETER								
	MIN	NOM	MAX						
D	4.90	5.00	5.10						
E	5.90	6.00	6.10						
Α	0.70	0.80	0.90						
A1	0.20 BSC								
A2			0.10						
D1	1.60	1.70	1.80						
E1	3.65	3.75	3.85						
L1	0.45	0.55	0.65						
L2	0.80 BSC								
b	0.30	0.40	0.50						
е	1.27 BSC								

电性参数 🔊

Product	结构 Configuration	产品 极性 Type	漏源电压 V _{DSS} (V)	工作电流I _D (A)	耗散功率 Pd (W)	栅源电压 V _{GS} (V)	阈值电压 Vth(V)		导通电阻 Rdson(mΩ) @VGS10V		导通电阻 Rdson(mΩ) @VGS4.5V		输入电容 Ciss (pF)	输出电 容Coss (pF)	反向传 输电容 Crss (pF)	栅极电荷 Qg (nC)	封装类型 Package	
							Min	Тур	Max	Тур	Max	Тур	Max	Тур	Тур	Тур	Тур	Tackage
YJG40NP03A	Dual	N/P	30 -30	40 -40	21 35	±20 ±25	1 -1.2	1.5 -1.8	2.5 -2.8	8 13	10 17	12 17	14 27	1015 2152	201 308	164 242	23.6 40.1	DFN5060
YJG20NP06A	Dual	N/P	60 -60	20 -20	35 50	±20	1 -1.3	1.5 -1.9	2.5 -2.5	24 35	30 45	28 49	40 65	1180 1060	70 400	60 20	26 18.7	DFN5060
YJG10NP10A	Dual	N/P	100 -100	10 -18	30 72	±20	1.1 -1	1.8 -1.8	3 -2.5	90 88	110 110	95 95	120 120	900 1050	35 120	30 25	16 20	DFN5060

更多详情参见官网

应用领域♪

■直流(DC)风扇 ■节能(EC)风扇 ■薄型离心扇 ■风扇数组 ■热插入风扇 ■风扇模块









